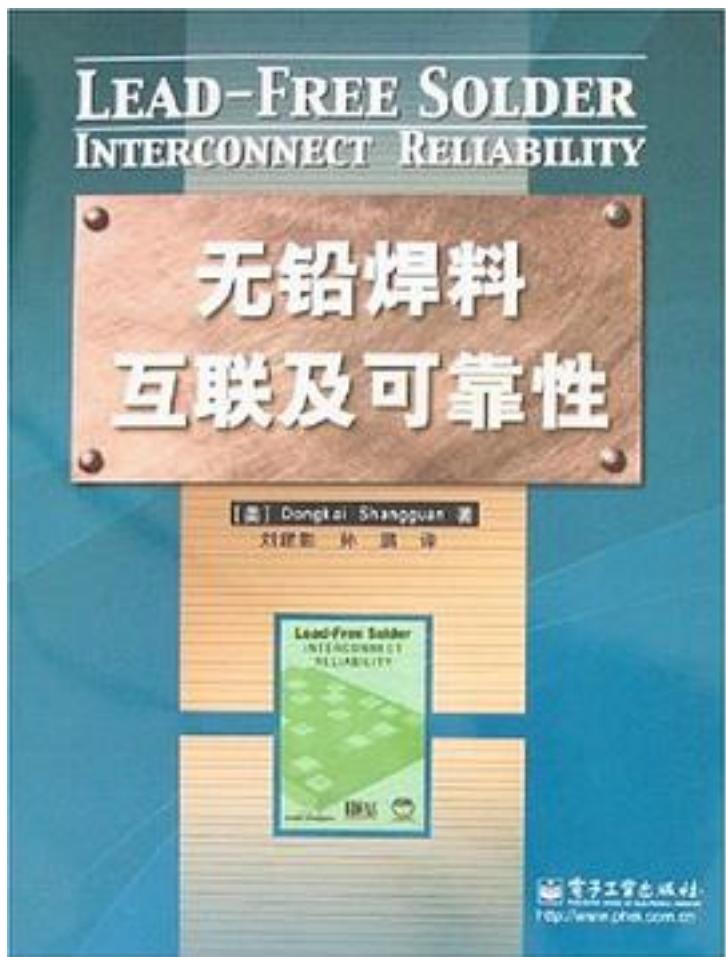


无铅焊料互联及可靠性



[无铅焊料互联及可靠性 下载链接1](#)

著者:上官东恺

出版者:电子工业

出版时间:2008-1

装帧:

isbn:9787121054679

《无铅焊料互联及可靠性》系统地介绍了无铅焊料焊点及其可靠性研究的最新成果，涵盖了无铅焊料焊点及其可靠性相关的各个方面，包括无铅合金焊料的各种组份、无铅焊料中的金属间化合物、“锡晶须”生长、锡铅焊料与无铅焊料的可靠性比较，以及焊点

失效机理、失效模式和失效测试估计方法等。导电胶也是一种常用的锡焊料替代品，《无铅焊料互联及可靠性》也专门讲述了和导电胶相关的一些可靠性问题。

作者介绍:

目录:

[无铅焊料互联及可靠性](#) [下载链接1](#)

标签

改变自己

评论

[无铅焊料互联及可靠性](#) [下载链接1](#)

书评

[无铅焊料互联及可靠性](#) [下载链接1](#)